

广东德豪润达电气股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金数额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]565 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）36,832 万股，每股发行价 5.43 元，募集资金总额为人民币 1,999,977,600.00 元，扣除发行费用人民币 30,877,753.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,969,099,846.04 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 19 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10698 号《验资报告》验证。

本公司已将募集资金人民币 492,274,961.51 元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至 2017 年 11 月 8 日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10087 号验资报告验证确认。

本公司已将募集资金人民币 1,476,824,884.53 元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至 2017 年 11 月 8 日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第 10086 号验资报告验证确认。

（二） 募集资金使用情况和结余情况

本次募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入的金额为人民币 223,324,294.20 元，其中：LED 芯片级封装项目累

计投入 13,352,000.00 元，LED 倒装芯片项目累计投入 209,972,294.2 元，累计变更募集资金用途 1,763,798,117.17 万元（累计投入项目以及变更用途的资金包含了累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币 18,022,565.33 元）。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

(二) 三方监管情况

根据管理制度，公司于 2017 年 11 月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司大连德豪于 2017 年 11 月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

公司之子公司蚌埠三颐于 2017 年 11 月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储情况

2017 年 10 月 19 日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币 1,969,099,846.04 元以及当时尚未支付的发行费用人民币 1,632,470.95 元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	募集资金余额	备注
广东德豪润达电气股份有限公司	平安银行股份有限公司珠海分行	15123451234526	0	LED 倒装芯片项目、LED 芯片级封装项目
大连德豪光电科技有限公司	大连银行股份有限公司第三中心支行	800601209006744	0	LED 芯片级封装

单位名称	银行名称	账号	募集资金余额	备注
大连德豪光电科技有限公司	中国银行股份有限公司 大连金普新区分行	302574671054	562.97	LED 芯片级封装
大连德豪光电科技有限公司	中信银行股份有限公司 大连分行	8110401014000360593	0	LED 芯片级封装
蚌埠三颐半导体有限公司	平安银行股份有限公司 合肥分行	15168968968999	2,924,003.45	LED 倒装芯片项目
蚌埠三颐半导体有限公司	合肥科技农村商业银行 股份有限公司大兴支行	20000443201510300000091	6,150,692.15	LED 倒装芯片项目
蚌埠三颐半导体有限公司	合肥科技农村商业银行 股份有限公司大兴支行	20000443201510300000106 协定存款户	0.00	LED 倒装芯片项目
合计			9,075,258.57	

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 9,075,258.57 元（全部为收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内募集资金投资项目的资金使用具体情况详见本报告“一、（二）募集资金使用情况和结余情况”以及附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 11 月 27 日止，募集资金投资项目 LED 倒装芯片项目先期投入金额人民币 93,982,612.25 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 1 日出具信会师报字[2017]第 ZC10718 号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

2017 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 2 月 12 日，公司第五届董事会第三十四次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2017 年度非公开发行 LED 芯片级封装及

LED 倒装芯片项目的闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2019 年 4 月 23 日，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，上述临时补充流动资金的募集资金用途变更为永久补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2019 年 4 月 23 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将截止 2019 年 3 月末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的 8.2177 亿元、暂时补充流动资金的 9 亿元，以及募集资金账户里的余额 1045.60 万元（全部为累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施时结转的金额为准）合计 173,222.60 万元全部变更用途为永久补充流动资金，同时补充确认了公司在紧急情况下使用的 3100 万元用于发放员工工资的情形为募集资金用途的变更。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年下半年，公司募集资金账户出现异动，异动金额合计 8.5277 亿元，详见公司于 2018 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金账户异动情况的公告》（公告编号：2018-129）。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

2019 半年度

单位：人民币万元

募集资金总额	196,909.98					本年度投入募集资金总额	4,323			
报告期内变更用途的募集资金总额	173,222.6					已累计	22,332.43			
累计变更用途的募集资金总额	176,322.6					投入募				
累计变更用途的募集资金总额比例	89.54%					集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. LED 芯片级封装	否	49,227.50	1,335.20	52.20	1,335.20	100%	不适用	不适用	不适用	是
2. LED 倒装芯片项目	否	147,682.48	20,997.23	4,270.80 (注 1)	20,997.23	100%	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计		196,909.98	22,332.43	4,323	22,332.43	---				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于 1、LED 设备价格在下降，但单机效率在提升，行业进入门槛在降低；2、LED 芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，导致 LED 芯片价格持续下跌；3、宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得 LED 芯片下游需求有所减少，进一步导致了 LED 芯片价格的下跌；4、LED 倒装芯片的下游手机、汽车等市场亦不太乐观；同时综合考虑以下因素：(1) 公司上述两个项目实际形成的产能已满足公</p>									

	<p>司目前的订单需要；(2) 募投项目盈利能力不佳，处于亏损状态，继续投入不符合公司及股东的利益；终止使用募集资金对募投项目进行投入可降低公司经营风险、财务成本；(3) 2018年下半年以来公司大额募集资金被银行划扣，贷款规模被银行强行压减，公司短期内已无力继续对该募投项目进行投入。因此，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。具体详见公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2019-26)。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>募集资金投资项目LED倒装芯片项目先期投入金额人民币9,398.26万元，经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年2月12日，公司第五届董事会第三十四次会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2017年度非公开发行LED芯片级封装及LED倒装芯片项目的闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>2019年4月23日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，上述临时补充流动资金的募集资金用途变更为永久补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019年4月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对募集资金投资项目的投入，并将截止2019年3月末公司尚未投入募投项目的募集资金包含前期被银行扣划的8.2177亿元、暂时补充流动资金的9亿元，以及募集资金账户里的余额1045.60万元(全部为累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额，具体金额以实施时结转的金额为准)合计173,222.60万元全部变更用途为永久补充流动资金，同时补充确认了公司在紧急情况下使用的3100万元用于发放员工工资的情形为募集资金用途的变更。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018年下半年,公司募集资金账户出现异动,异动金额合计8.5277亿元,详见公司于2018年12月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于募集资金账户异动情况的公告》(公告编号:2018-129)。
----------------------	---

注1: 4,270.80万元主要是募投项目设备的尾款。